

# Rodzaje pamięci, interfejsów oraz wyświetlaczy

Wykład 3

Technologie na urządzenia mobilne

Wojciech Światała

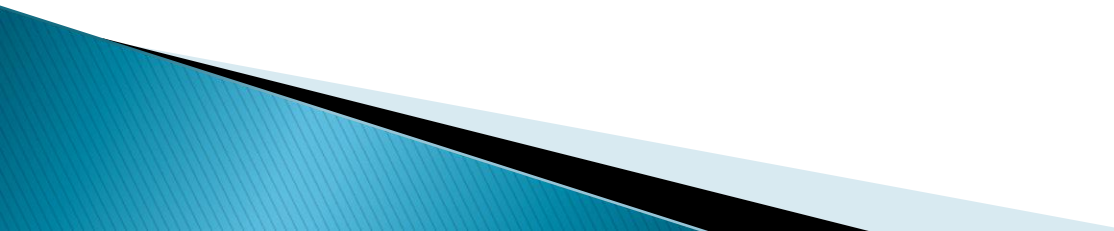
[wojciech.switala@cs.put.poznan.pl](mailto:wojciech.switala@cs.put.poznan.pl)

<http://www.cs.put.poznan.pl/~wswitala>

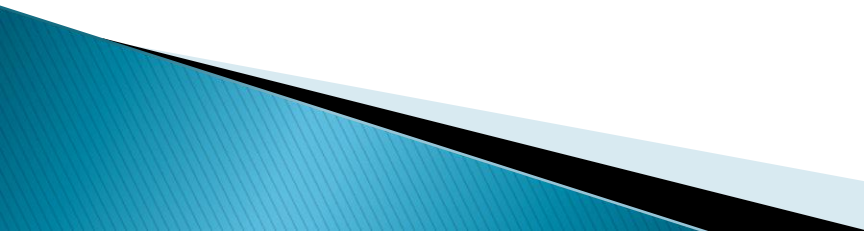
# Bibliografia

- ▶ Sztuka Elektroniki – P. Horowitz, W.Hill
- ▶ Układy półprzewodnikowe – U.Tietze, Ch. Schenk
- ▶ Projektowanie układów analogowych – Robert A.Rease
- ▶ Układy Cyfrowe – Wojciech Głocki – WSiP
- ▶ Filtry analogowe i cyfrowe – Jacek Izydorczyk, Jacek Konopacki – PAN
- ▶ Lokalne interfejsy szeregowo w systemach cyfrowych – Jacek Bogusz – BTC
- ▶ Zasilacze urządzeń elektronicznych – Joseph J.Carr – BTC
- ▶ Mikrokontrolery w systemach zdalnego sterowania – Zbigniew Hajduk – BTC
- ▶ Pamięci masowe w systemach mikroprocesorowych – Paweł Marks – BTC
- ▶ Cyfrowe przetwarzanie sygnałów – Tomasz P. Zieliński – WKŁ
- ▶ Moduły GSM w systemach mikroprocesorowych – J Bogusz – BTE
- ▶ Systemy GPS – Cezary Specht – BERNARDIUM
- ▶ GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne – Janusz Narkiewicz – WKŁ
- ▶ Technologie i materiałoznawstwo dla elektroników – Zbigniew Szczepiński , Stefan Okoniewski WSiP

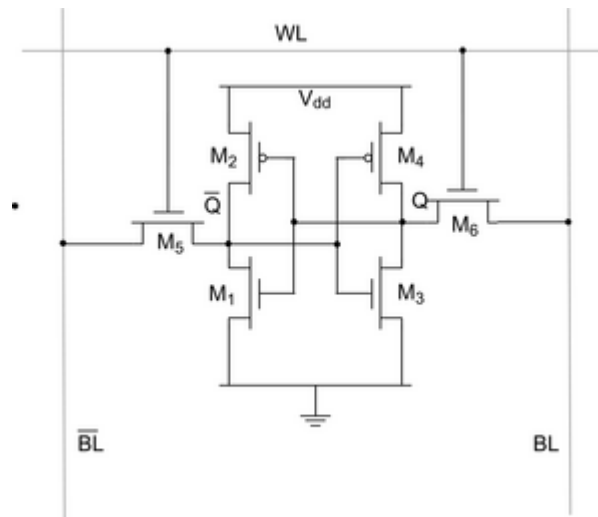
# PAMIĘCI

- ▶ SRAM, DRAM, SDRAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH, FRAM, MRAM
  - ▶ RAM – Random Access Memory
  - ▶ SAM – Serial Access Memory
  - ▶ NVRAM – Non-Volatile Random Access Memory
- 


# SRAM

- ▶ Static Random Access Memory
  - ▶ Równomierny czas dostępu do każdej komórki pamięci
  - ▶ Struktura opiera się na przerzutnikach typu flip-flop
  - ▶ Mniejsza ilość pamięci na powierzchnie układu niż w przypadku DRAM
  - ▶ Wysoka cena
  - ▶ Używana jako pamięć CACHE
- 

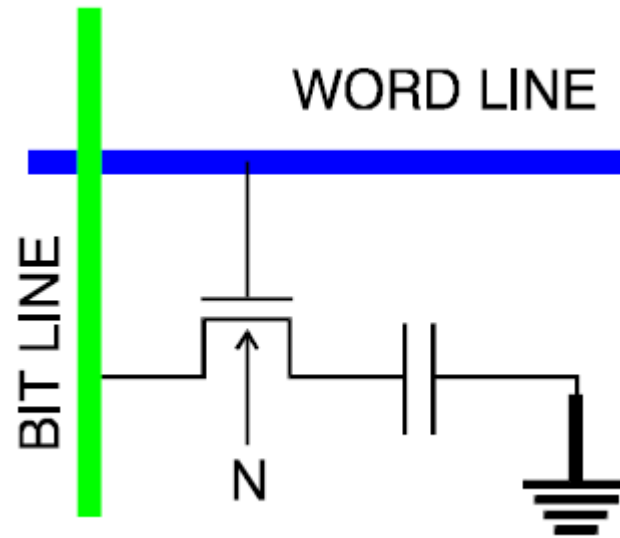
# SRAM – pojedynczy bit



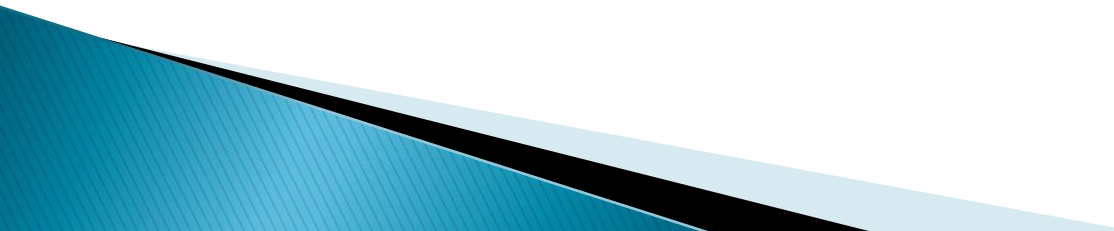
# DRAM

- ▶ Dynamic Random Access Memory
  - ▶ Czas dostępu zależny od procesu odświeżania i strony
  - ▶ Jedna komórka zawiera mniej elementów przez co można uzyskać większą pojemność na jednostkę powierzchni
  - ▶ Znacznie tańsza od SRAM
  - ▶ SDRAM: Synchronous dynamic random access memory
  - ▶ wymaga odświeżania
- 

# DRAM - pojedynczy bit



# ROM, PROM, EPROM

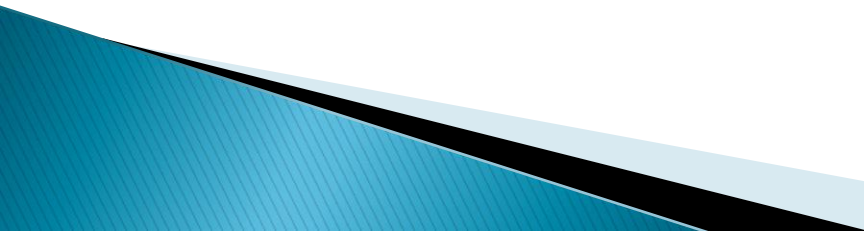
- ▶ ROM – Read-Only Memory
  - ▶ PROM – Programmable Read-Only Memory
  - ▶ EPROM – Erasable Programmable Read-Only Memory (Kasowanie przy pomocy UV, też są odmiany OTP – One-Time Programmable)
  - ▶ Do programowania wymagane zwykle większe napięcie (12V)
- 



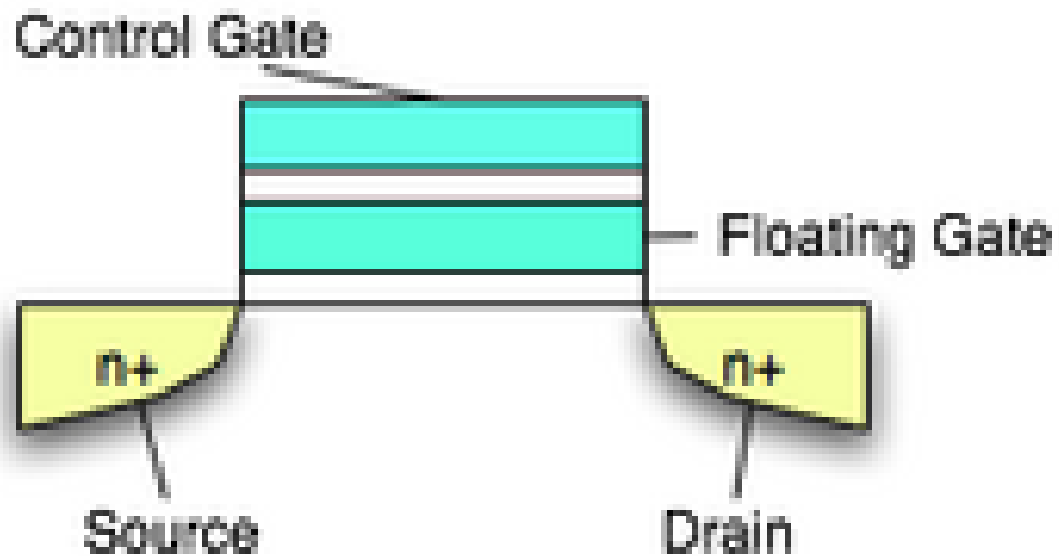
# EPROM



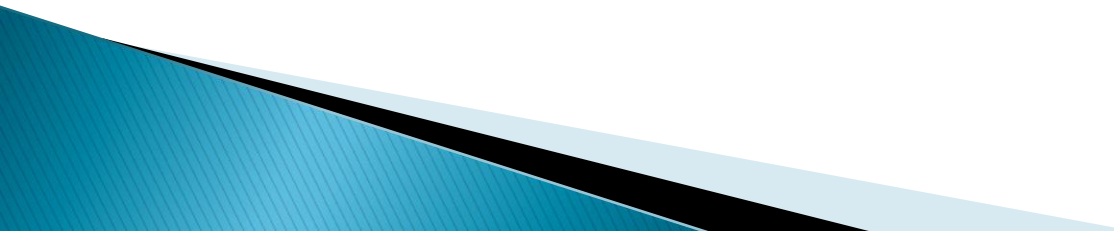
# EEPROM

- ▶ EEPROM – Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
  - ▶ Programowanie/Odczyt pojedynczych bajtów
  - ▶ Dostępne jako pamięć równoległa lub szeregową (SPI, I<sup>2</sup>C, 1-Wire)
  - ▶ Zapis dzięki pływającej bramce
  - ▶ Przechowywanie do 10 lat bez zasilania
  - ▶ Cykle zapisu 1 000 000
- 

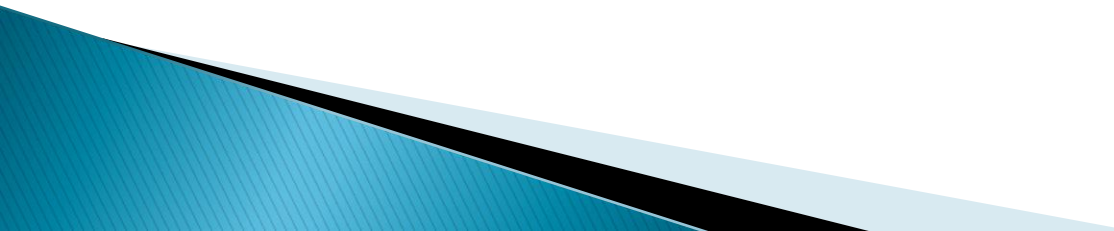
# EEPROM – pływająca bramka



# FLASH

- ▶ Odmiana pamięci EEPROM
  - ▶ Większe bloki pamięci
  - ▶ Pierwsze wersje wymagały wymazywania całej zawartość pamięci
  - ▶ Obecnie kasowanie odbywa się w całych blokach
  - ▶ Programowanie pojedynczych bajtów
  - ▶ Wykasowana pamięć ma same 0xFF
- 

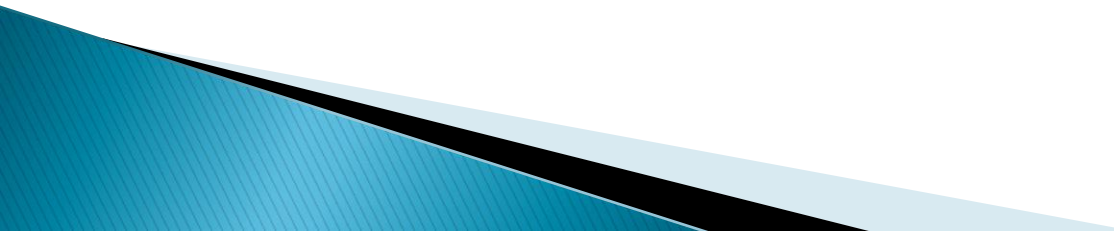
# Serial Flash

- ▶ Mała obudowa
  - ▶ Mała moc
  - ▶ Komunikacja poprzez magistrale szeregową SPI
  - ▶ Mniejsza ilość połączeń niż w przypadku dostępu równoległego
- 

# FRAM, FeRAM

- ▶ Ferroelectric RAM
- ▶ Zasada działania podobna do DRAM
- ▶ Kondensator zawiera materiał ferroelektryczny jako dielektryk

# MRAM

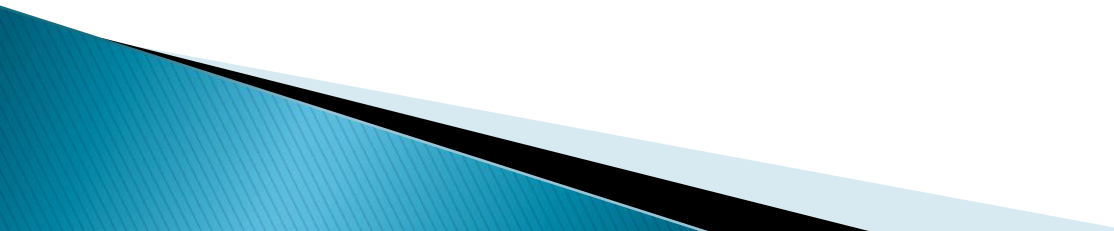
- ▶ Magnetoresistive Random Access Memory
  - ▶ Informacje przechowywane w elementach magnetycznych
  - ▶ Informacja zapisana poprzez polaryzacje pól w strukturze.
  - ▶ Odczyt poprzez pomiar rezystancji wywołanej polem magnetycznym.
- 

# MAGISTRALE DANYCH

- ▶ SPI, I<sup>2</sup>C, Microwire, SMBus, CAN, 1-Wire, RS-232, RS-485



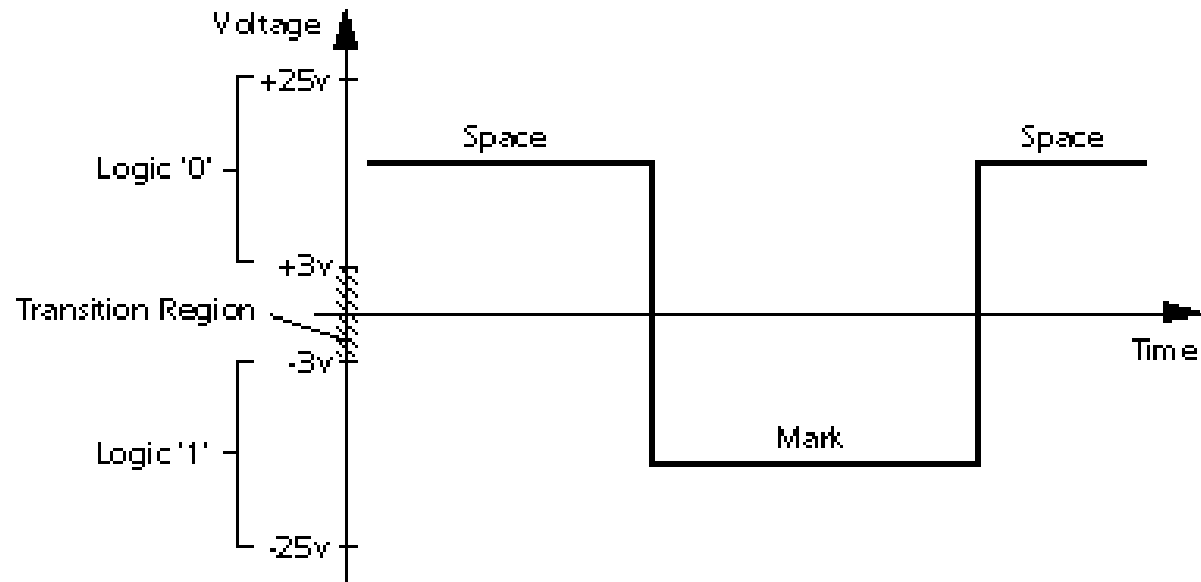
# Rodzaje magistral

- ▶ Równoległe (LPT)
  - ▶ Szeregowe (RS232, I2C, CAN, 1-Wire,...)
  - ▶ Synchroniczne (I2C, SPI, JTAG)
  - ▶ Asynchroniczne (RS232, 1-Wire,CAN)
- 

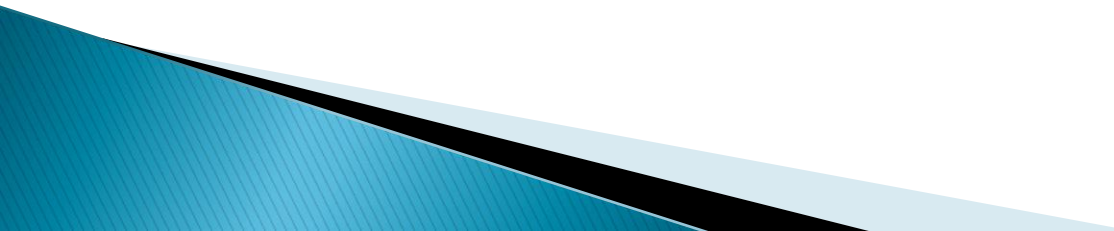
# RS-232

- ▶ Recommended Standard 232 w 1962r
- ▶ Łączenie urządzeń DTE (Data Terminal Equipment) z DCE (Data Communication Equipment)

# RS-232



# RS-232C

- ▶ Do 15m
  - ▶ Do 20 kbit/s
  - ▶ Łącze niesymetryczne
  - ▶ Transmisja asynchroniczna znakowa (odstęp pomiędzy znakami dowolny)
  - ▶ Transmisja synchroniczna (grupowanie w ciągi bajtów)
- 

# RS-232

## Transmisja asynchroniczna

- ▶ Bit startu
- ▶ Bity danych począwszy od LSB
- ▶ Opcjonalny bit kontroli (even, odd)
- ▶ Jeden lub dwa bity stopu

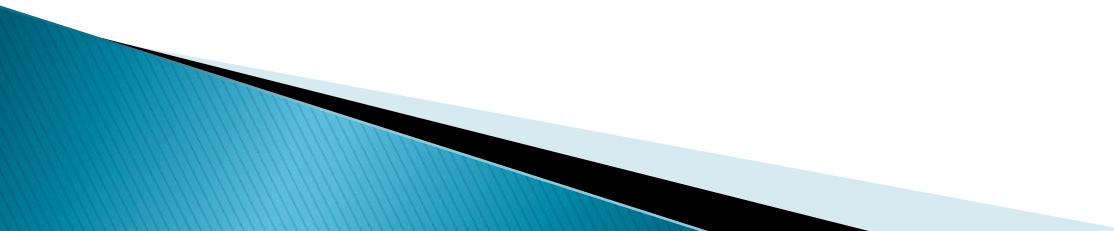
## Transmisja synchroniczna

- ▶ Brak bitów startu i stopu
  - ▶ Bajty początkowe i końcowe
- 

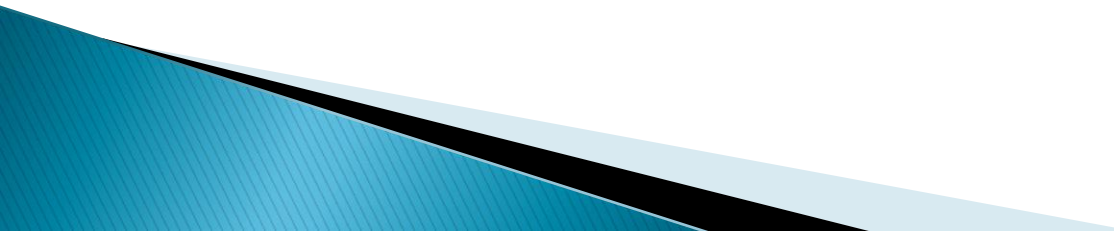
# RS-232

- ▶ Złącza 25 lub 9 pinowe

Sygnały:

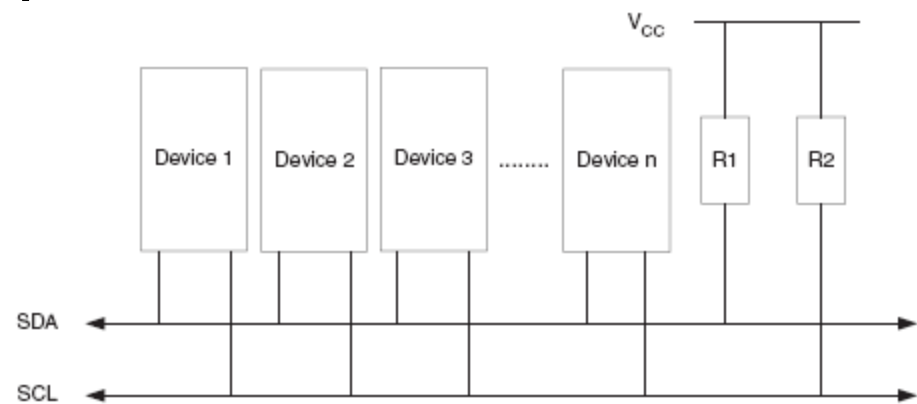
- ▶ GND (masa)
  - ▶ TxD (Transmitted Data)
  - ▶ RxD (Received Data)
  - ▶ RTS (Request to Send)
  - ▶ CTS (Clear to Send)
- 

# RS-485

- ▶ Symetryczny zrównoważony system transmisyjny
  - ▶ Półdupleksowy
  - ▶ Komunikacja wielopunktowa (wiele nadajników i odbiorników)
  - ▶ Sygnał różnicowy
  - ▶ Do 1200m
  - ▶ Do 10 Mbit/s
- 

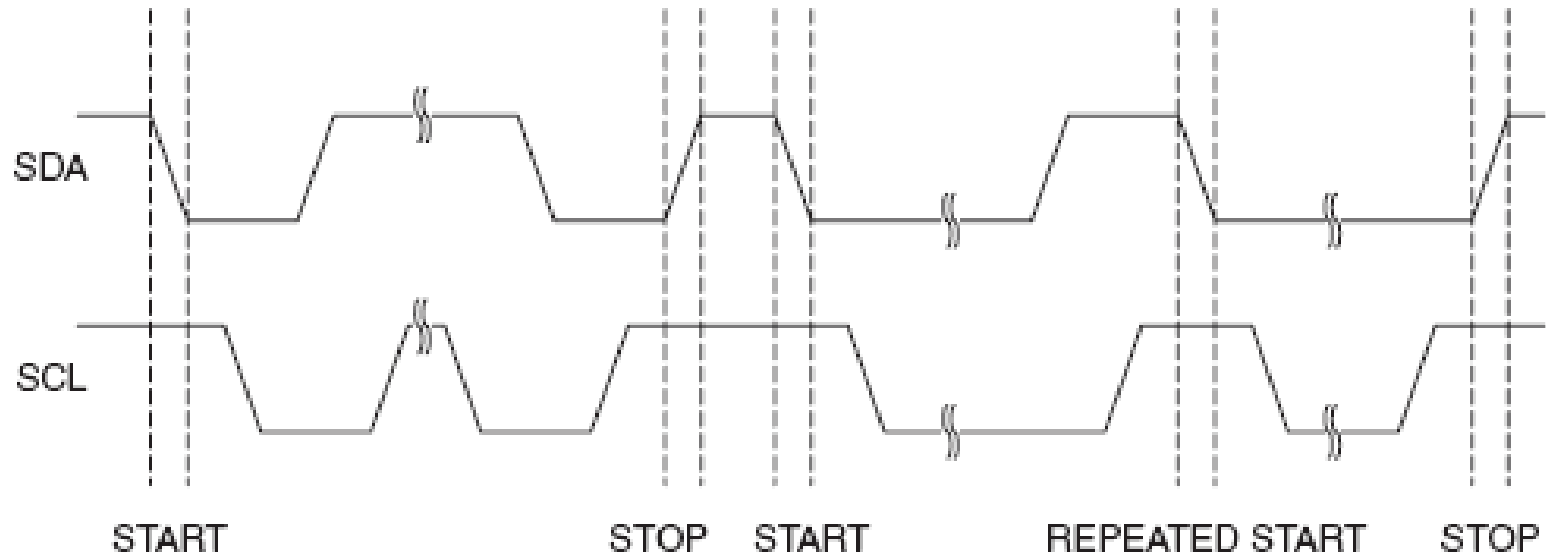
# I<sup>2</sup>C

- ▶ Szyna danych SDA
- ▶ Szyna zegarowa SCL
- ▶ Transmisja może odbywać się kiedy nikt inny nie nadaje
- ▶ Wykrywanie kolizji dzięki arbitrażowi
- ▶ Do 100 lub 400 kbps

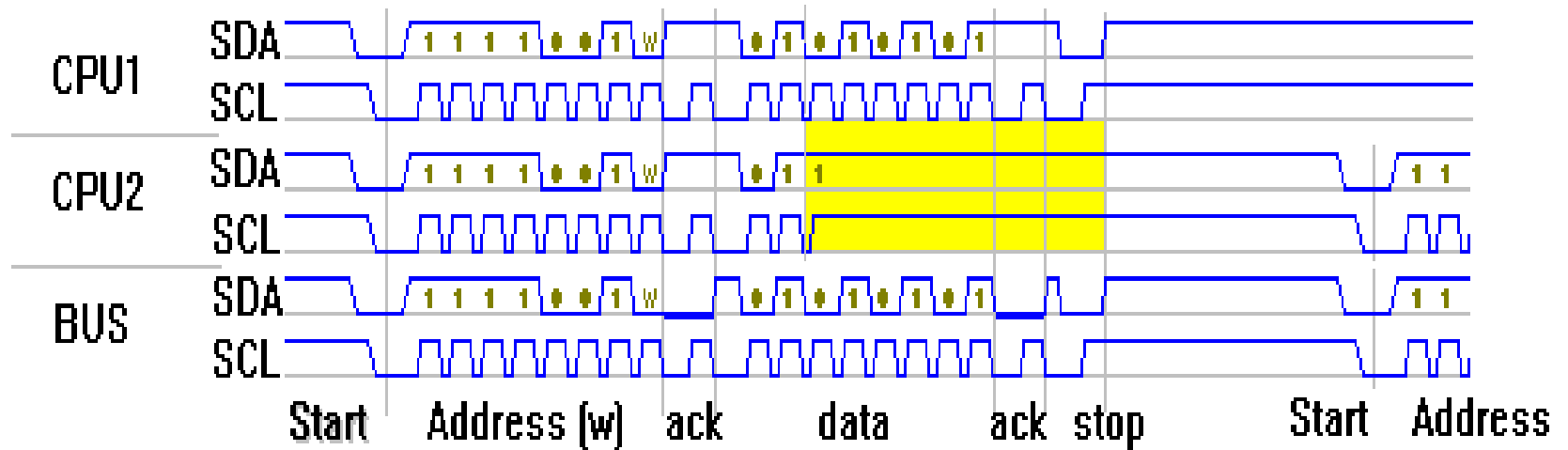




# I<sup>2</sup>C



# I<sup>2</sup>C



# SPI

- ▶ Serial Peripheral Interface
- ▶ Jedno urządzenie master i wiele slave
- ▶ Transmisja synchroniczna

Komunikacja 4 przewodowa:

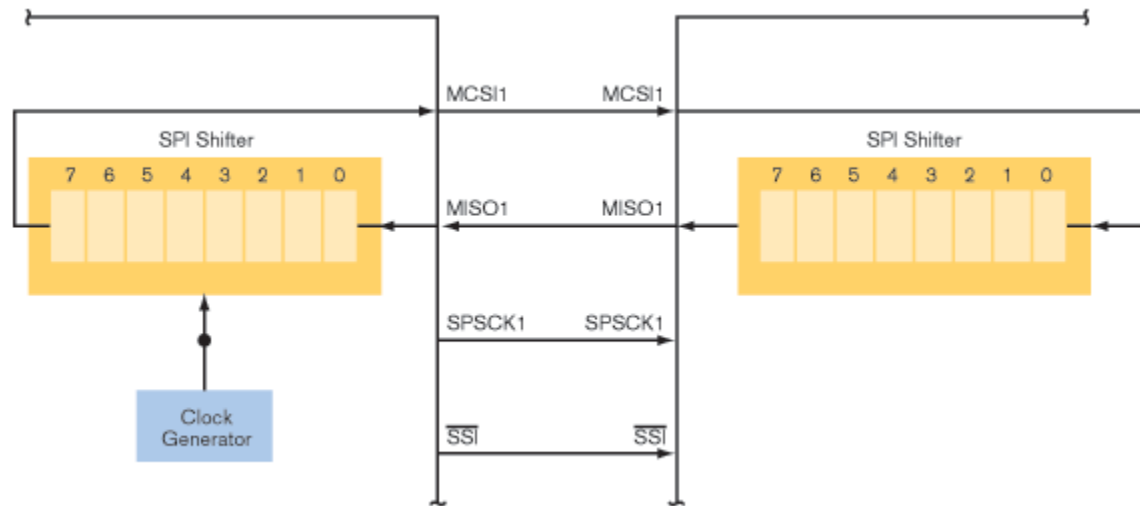
CS (Chip Select)

MOSI (Master Out Slave In)

MISO (Master In Slave Out)

SCK (Serial Clock)

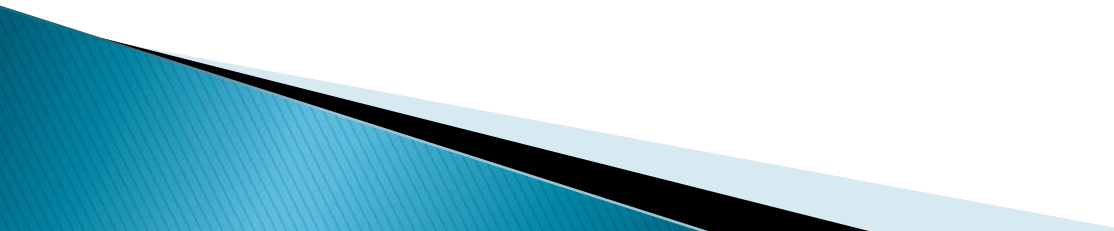
# SPI



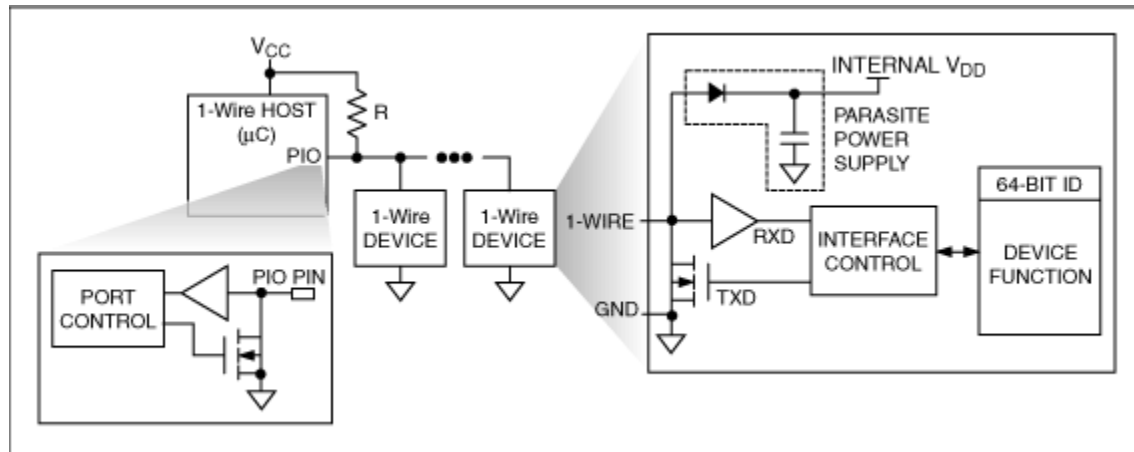
# MicroWire

- ▶ Starsza odmiana SPI
- ▶ Połączenie za pomocą  
SK (Clock)  
SI (Serial IN)  
SO (Serial OUT)

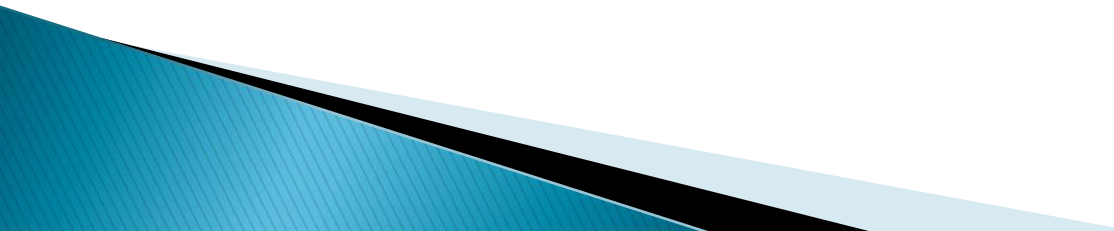
# 1 –Wire

- ▶ Komunikacja po „jednym przewodzie”
  - ▶ Half-duplex
  - ▶ Zasilanie po szynie danych
  - ▶ Jedno urządzenie master
  - ▶ 64 bitowe numery seryjne
  - ▶ Standardowo 15kbps
  - ▶ 1 i 0 kodowane na szerokość impulsu
- 

# 1-Wire



# SMBus

- ▶ System Management Bus
  - ▶ Bazuje na I<sup>2</sup>C
  - ▶ SMBDAT
  - ▶ SMBCLK
  - ▶ Zasilanie z szyny danych
  - ▶ Od 10 do 100KHz
- 



# CAN

- ▶ Controller Area Network
- ▶ Jest to szeregowy protokół komunikacyjny zapewniający komunikacje Real Time oraz zwiększone bezpieczeństwo

- ▶ Do 1 Mbit/s

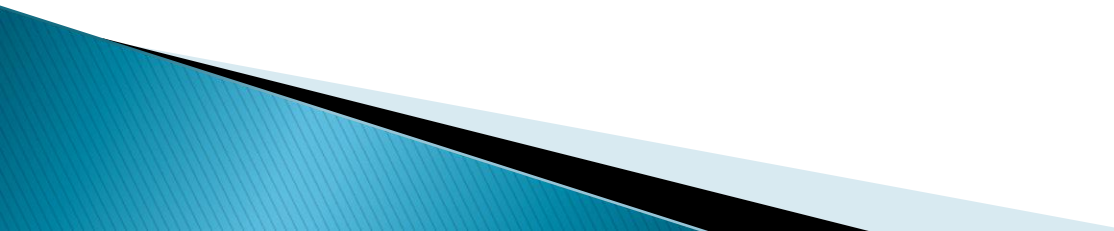
- ▶ Podział na warstwy:

Warstwa obiektów

Warstwa transferów

Warstwa fizyczna

# CAN

- ▶ Bit początku ramki
  - ▶ pole ID (11 lub 29 bit)+ bit nad/odb (arbitraż)
  - ▶ Pole kontrolne
  - ▶ Dane
  - ▶ CRC
  - ▶ Potwierdzenie ACK
  - ▶ Koniec Ramki
- 

# JTAG

- ▶ Joint Test Action Group
- ▶ Standard IEEE 1149.1
- ▶ Do 100MHz (10–100ns/bit)
- ▶ Komunikacja poprzez:

TDI (Test Data In)

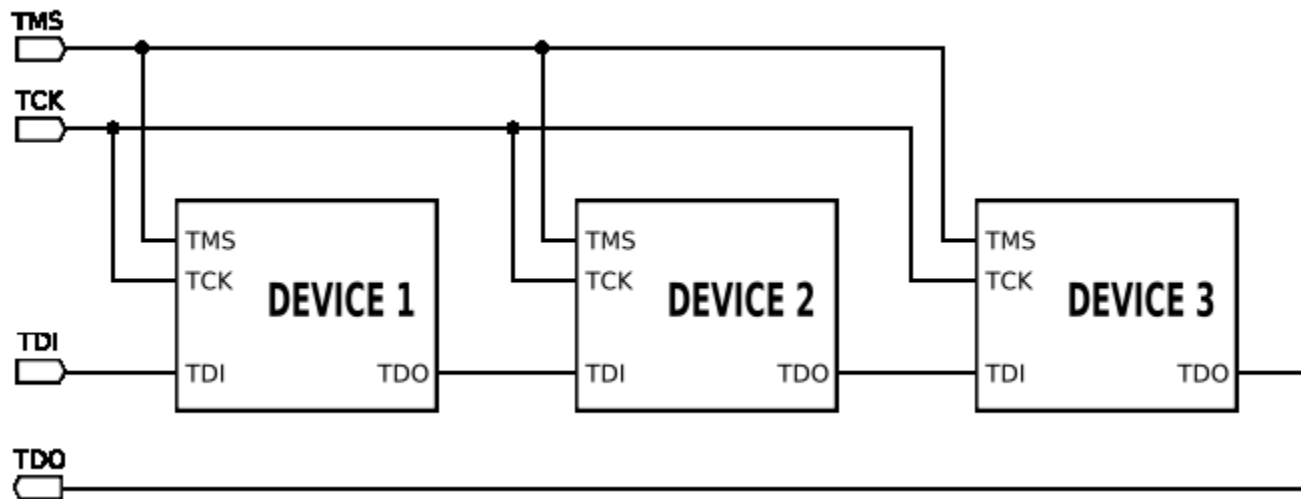
TDO (Test Data Out)

TCK (Test Clock)

TMS (Test Mode Select)

TRST (Test Reset) opt

# JTAG

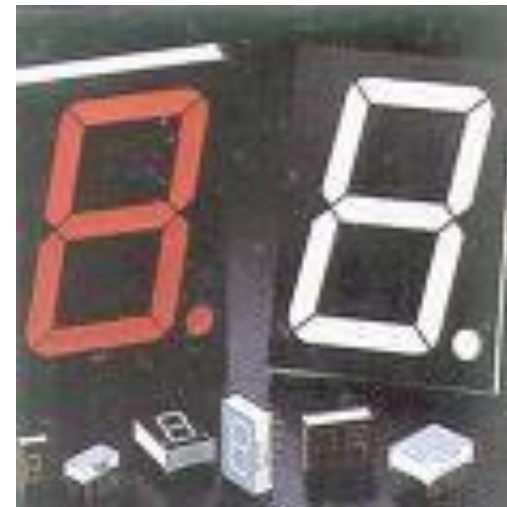


# WYŚWIETLACZE

- ▶ LED, LCD, OLED

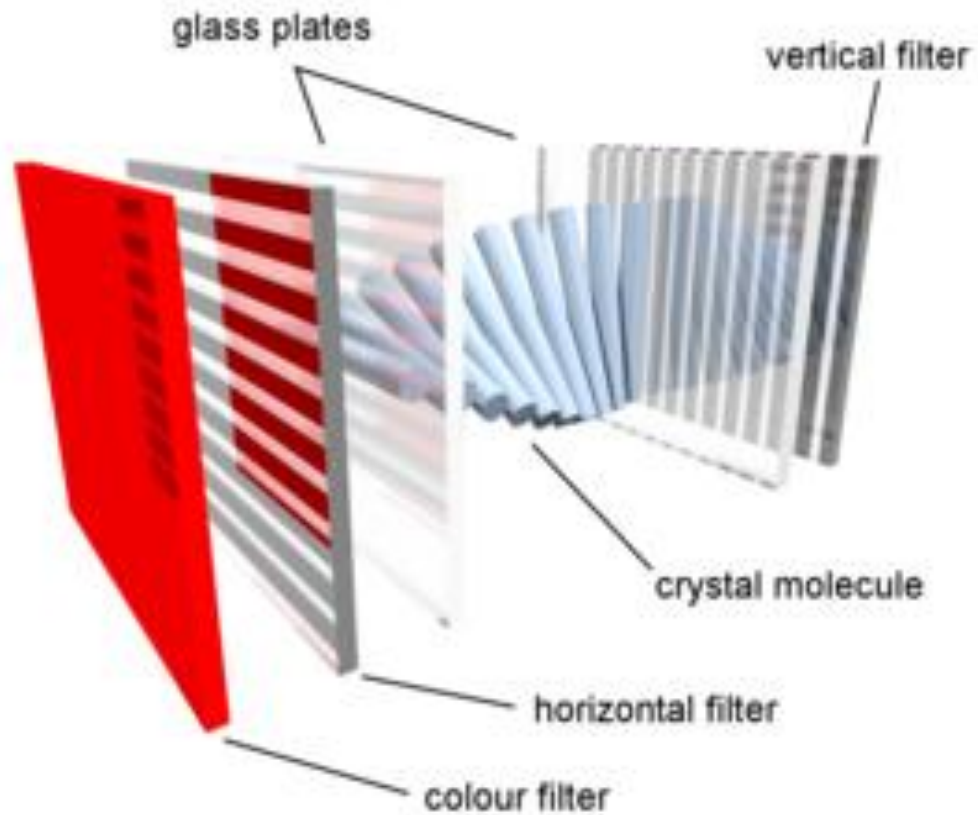
# LED

- ▶ Light Emitting diode
- ▶ Wyświetlacze zbudowane z segmentów lub punktów
- ▶ Duże wyświetlacze mają w segmencie po kilka diod połączonych szeregowo

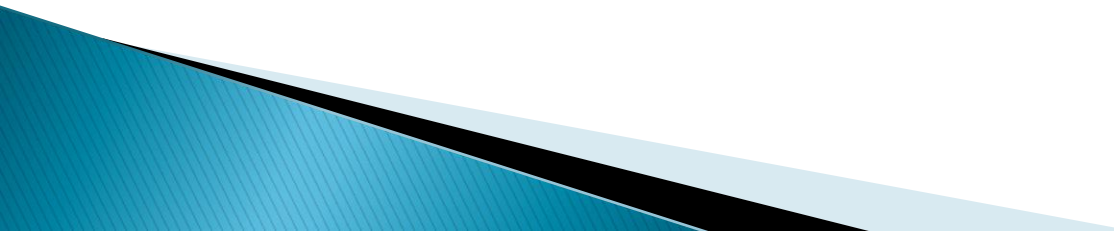


# LCD

- ▶ Liquid Crystal Display
- ▶ Wymaga podświetlania



# OLED

- ▶ Organic light-emitting diode
  - ▶ Wykorzystują strukturę organiczną
  - ▶ Nie potrzebują podświetlenia jak LCD
  - ▶ Żywotność jak CRT (wymagany wygaszacz ekranu)
  - ▶ Czas reakcji 0,01ms (LCD ma 8 – 12ms)
- 



# Inne wyświetlacze

- ▶ Cathode ray tube (CRT)
  - ▶ Digital Light Processing (DLP)
  - ▶ Field emission display (FED)
  - ▶ Liquid crystal on silicon (LCOS)
  - ▶ Plasma display panel (PDP)
  - ▶ Surface-conduction electron-emitter display (SED)
  - ▶ Vacuum fluorescent display (VFD)
- 